(B)日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

◎公開特許公報 (A)

昭54-73260

Mint. Cl.² H 01 C 7/00 H 01 C 1/14 識別記号 〇日本分類

59 D 112

庁内整理番号

❸公開 昭和54年(1979)6月12日

6918--5E

6664-5E

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 3 頁)

動チップ状抵抗体部品およびその製造方法

②特

頭 昭52—140996

❷出

图52(1977)11月24日

の発 明 者

戸波善茂 東京都千代田区内神田 2 丁目14 番 6 号 東京電気化学工業株式

会社内

00発明者小山昭雄

東京都千代田区内神田 2 丁目14 番6号 東京電気化学工業株式

会社内

切出 願 人 東京電気化学工業株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番

1号

朝 都 書

1発明の名称

チップ状無抗体部品およびその製造方法

2.特許請求の範囲

- (1) 抵抗材料が設けられた絶難性基板の少くとも一つの対向する片の各々には少くとも「個の凹部が設けられており、前配片および凹部に電板材料が設けられていることを特徴とするチップ状抵抗体部品。
- (a) 絶級性基板に分割用機および飲分割用機に 固角に實通孔を設けた後、前記分割用機およ び貫通孔に電極を、また摂邸の基板に抵抗材料を開着することを特徴とするチップ状抵抗 体部品の製造方法。

4.発明の詳細な説明

本発明は各種電子装置等に用いられるチップ 状抵抗体部品およびその製造方法に関するもの である。

近年、電子装置の小型化即ち実装密度の向上、ならに信頼性の向上を目的として、各種電子部

品は、ペークライト樹脂、エポキン樹脂等の基板よりなる印刷回路基板(いわゆるPCポート)にハンダ等により接続して用いられている。

かかる電子部品のうち、抵抗体部品に要求される事項としては、印刷用回路基板へのハング 鉄磁が容器で、かつ充分な接続強度を有すること、接続したテップ状無抗体部品間の抵抗値の バラッキが小さいこと、さらに緊係であること があげられる。

第1 関および第2 関は従来のチップ状 抵抗体 部品の構造を示すもので、第1 図は基板上の皮 族抵抗と同一面の両端に驾標をつけたもの、第 2 図は基板上の皮膜抵抗を含んで基板の両端を くるむように電極をつけたものを示す。 なお図 面において、1 は基板、2 は皮膜抵抗、および

前者は、通常用いられる高価な電砂材料の使用量が少なくですみ、チップ状抵抗体部品の製造に移して1度に複数個皮膜抵抗および電極の固治が可能であるため、製造が容易である反面、

電転が皮膜抵抗と同一散小薬板面上におるため、 印刷回路基板にヘンダ接続する際、ヘンダ水皮 膜抵抗に接触しやすく、抵抗値パラツキの発生 の原因ともなつていた。

一方後者は、皮膜抵抗と印刷函路基板面を向 いあわずことがないため、前者のような欠点は ないが、高価な電筋材料の使用量が多く、また くるむように電極を付けるため前者より量量能 率の面で劣るものであつた。さらに印刷回路基 板がエポキシ等の機能系よりなる場合、温度、 最度等の環境変化によって、膨張、収集変化が 大きく、この変化がハングを介して電路を設労 破壊してしまい、信頼性に欠けるものであった。

本発明は上述の問題点を解決した改良された テンプ状抵抗体部品を提案するもので、高信報 性、易製造性、および安価を目的とするもので ある.

すなわち本発明は抵抗材料が設けられた絶縁 性基板の少くとも一つの対向する片の各々には 少くとも1個の凹部を設け、前配片および凹部

定形状にスクリーン印刷し、乾燥後貫通孔(51) の内観およびX方向の分割用業の周辺の所定形 状を電板 (51)として例えば AF-Pd 電影ペース トを集布、印刷し続成する。その後XY方向の 分割用器 (A)を介して分割することにより、第 8 図に示されたテップ状抵抗体部品の多数値を 得ることができる。

以上の影明から明らかなごとく、本発明のテ ンプ状低抗体部品は凹部(41)に電極水形成され ていることを大きな特徴とするもので、との斟 部(41)に形成された電框を介して印刷記載並収 にハング等の尊電性接着剤で固着することによ り、電極部での制度や、抵抗値のバラフキの心 配もない信頼性の高い、かつ余分な電差材料も 使う必要のない安価なチップ状抵抗体部品とす ることが出来るものである。

4.図面の簡単な説明

第1回および第2回は従来のテップ状抵抗体 郵品の構造を示す。

第3回および第4回は本発明のチップ状抵抗

特関昭54-73260(2) に電価材料を設けたチップ状紙抗体都品および このテップ状態技体部品の製造方法を提案する ものである。

以下本発明の構造を図画を参照して影明する。 第 8 因は本発明のチップ状抵抗体部品の一例 を示すもので、基板 (ii) の対向する蝋都には凹 部 (41) が形成されており、この凹部 (41) および 基板維軽には皮膜抵抗 (21) に接して電板 (31) が 設けられている。

第4回は基板 (11) の対向する端部に各々凹部 (41)が2つ設けられた他の実施例を示す。

次に第る間に示された構造のチップ状抵抗体 部島の製造方法について述べる。

・第5回に示されるどとを基板としては複数個 のテップ状態抗体部品を得るため、基板 (11) に はあらかじぬXY方向に分割用線(4)とY方向 2年8년 の分割装に貫通孔(51)を形成したものを用いる。

次になの基板(11)に第4回に示されるごとく 抵抗皮族 (21) として例えば RuOs 抵抗ペースト を各々XY分割用歳によつて囲まれたか所に所

体部島の構造を示す。

第5回および第6回は、第5回に示されたチ ププ状態抗体部品を製造するための説明例であ

1,11~基板

2,21~皮膜抵抗

8, 81 -- 電板

41 ··· 全量工業 几月部

61…分割用满

特許出職人 東京電気化学工業株式会社 代表宏 竖 唇 塔次郎

华字部

2 554.

-294-

特別昭54-73260(3)



